

2025 TIRT 技能積分賽暨高雄盃機器人挑戰賽

積體電路應用電路板設計競賽選手培訓

活動簡章(樹德場次)

課程名稱：2025 積體電路應用電路板設計競賽選手培訓

活動單位：樹德科技大學、台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會、財團法人桃園市祥儀慈善文教基金會

課程日期：2025/07/29~08/01 (星期二~五)

認證日期：2025/08/08(星期五) (正式考試半天)

課程地點：樹德科技大學 電腦與通訊系 圖資大樓 6F L0625 教室(同認證地點)

課程對象：全國高中職(五專部)/大專院校學生 (在校或應屆畢業生 / 含體制外學生)

課程費用：優惠價 4,000 元/位

(原價 7,000 元/位, 含：講師+助教費、講義費、訓練材料費、認證費、證書費, 不含午餐)
同時參加電子元件拆與鉗競賽選手培訓活動者;組合優惠價為 6,500 元 /位

活動梯次：

梯次	日期 (2025)	正取人數	教學內容	報名網址
培訓	07/29~08/01 (二~五)	30 位	課程+認證	https://www.temi.org.tw/news/view/404/ 
認證	08/08(五) 下午場次			

重要事項：

1. 煩請參與課程的學生於開課前，務必要熟讀學科題庫。
題庫下載：https://www.temi.org.tw/doc_download/
2. 由於課程緊湊，請參與課程的學生務必全程參與課程、勿缺席；並準時到教室，遲到將無法跟上進度。
3. 全程參與課程者，可獲得由祥儀基金會與 TEMI 協會共同頒發之培訓時數證書。
4. 通過認證考試者，可獲得 TEMI 協會能力認證證書(公協會/人力銀行背書)。
5. 學員可參加 2025TIRT 機器人國際賽-TEMI 積體電路應用技能積分賽、2025 高雄盃機器人挑戰賽-科技寶經典賽。
6. 學員參與認證，請務必攜帶具有大頭照之身份證件(如身份證或學生證)，做為考生身份核查之用。



(培訓時數證書)



(能力認證證書)

課程內容：

課程 時間	第一天 07/29(二)	第二天 07/30(三)	第三天 07/31(三)	第四天 08/01(二)	第五天 08/08(五)
08:45~09:00	學員簽到				學員簽到 08:00~08:45 認證規則說明 08:45~09:00
09:00~12:00	PADS Logic 介紹及操作	PADS Logic 基礎電路設計 (5-8 題)	PADS Layout 基礎電路設計 (1-4 題)	PADS Layout 進階電路設計 (1-2 題)	電路板設計 實用級認證 正式認證 學科測試 09:00~10:00 術科測試 10:00~12:00
12:00~13:00	午餐休息				賦歸
13:00~16:00	PADS Logic 基礎電路設計 (1-4 題)	PADS Logic 進階電路設計 (1-4 題)	PADS Layout 基礎電路設計 (5-8 題)	PADS Layout 進階電路設計 (3-4 題)	
16:00~16:15	學員簽退				

※如有變動，請依當日課程為主※

聯絡窗口：

單位	聯絡人	電話	電子郵件
台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會	李思萱專員	(02) 2223-9560#210	aleeb@etimag.com.tw

附件一、匯款資訊與自備工具

一、報名與匯款資訊：

1. 為確保每位參加同學皆能參與實作與競賽，每梯之每班報名名額以 40 人為限，若報名人數未達總該梯報名人數一半，將公告延期辦理。
2. 報名正取說明：依先報名並繳費完成的學員之優先順序，做為正取資格。
3. 報名期限：自培訓官網公告日期至活動前 7 天，或人數額滿為止。
4. 報名方式：請上 TEMI 網站報名 https://www.temi.org.tw/activity_lst/
5. 報名費繳費方式：
協會 TEMI（第一銀行）匯款帳號
銀行：第一銀行-仁愛分行（代號 007-1602）
戶名：台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會
帳號：160-10-082093
6. 繳交報名費後請將繳費收據<<註明梯次編號、學校、科系、姓名>>以掃描電子檔 e-mail 至 aieeb@etimag.com.tw，以確認報名順序。
7. 退費原則說明：學員因故不克參與活動(培訓、認證)；請於活動日前 10 天可 100% 全額退款，若逾期恕不接受退款，特此告知，造成不便之處，敬請見諒。

二、自備工具

項次	品名	規格	數量	參考圖示/說明
1	筆記型電腦	WINDOWS10(含以上)作業環境	1	應用於培訓時 可直接使用考場電腦 如要自主練習，請自備
2	USB 隨身碟	至少 8G	1	

附件二、會員註冊、認證報名及繳費流程

一、會員註冊：

姓名及mail 請勿隨意填寫，避免後台無法查詢 或 發mail 通知



最新消息 ▾ 關於協會 ▾ 能力認證 ▾ 技藝技職教育 ▾ 培訓活動 ▾ 競賽活動 ▾ 人力平台 ▾ 下載專區 ▾ 會員專區 ▾

培訓活動報名 | 最新消息 | 影音專區

電路板設計知識力認證講師研習

活動地點：TEMI教育訓練中心
活動日期：2024-08-31~2024-08-31
報名日期：報名截止

訊息公告 | 活動資訊 | 成果分享 | 競賽資訊 | 教師培訓

[2025-01-09] 報名現況
[2024-12-05] 德明技職力冬令營 - 積體電路應用知識力活動
[2024-11-14] 龍華2025TEMI技職力冬令營~電子元件拆錫實用級培訓暨認證

YouTube

協會電子報

最新消息 ▾ 關於協會 ▾ 能力認證 ▾ 技藝技職教育 ▾ 培訓活動 ▾ 競賽活動 ▾ 人力平台 ▾ 下載專區 ▾ 會員專區 ▾

首頁 / 會員註冊

能力認證報名入口 | 線上註冊會員



培訓活動報名

電路板設計知識力認證講師研習

活動地點：TEMI教育訓練中心
活動日期：2024-08-31~2024-08-31
報名日期：報名截止
» 更多活動查詢

聯絡資訊

台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會
信箱：temi@temi.org.tw
電話：(02)2223-9560#505

姓名 *
Email(登入系統帳號) *

密碼 *
密碼確認 *

國籍 *
台灣(TW)

圖像認證 *
imines imines

我已經閱讀 會員相關規定 隱私權政策

重寫資料 確認送出

※姓名及mail 請勿隨意填寫，避免後台無法查詢 或 發mail 通知

※記得勾選已閱讀

二、請於完成註冊後，登入系統填寫基本資料

最新消息 ▾ 關於協會 ▾ 能力認證 ▾ 技藝技職教育 ▾ 培訓活動 ▾ 競賽活動 ▾ 人力平台 ▾ 下載專區 ▾ 會員專區 ▾

首頁 / 會員登入

能力認證報名入口 會員登入

能力認證
Certification

培訓活動報名

電路板設計知識力認證講師
研習

活動地點：TEMI教育訓練中心
活動日期：2024-08-31~2024-08-31
報名日期：報名截止
» 更多活動查詢

聯絡資訊

公證出入卡證會員系統發展協會

請使用您的帳號登入
建議您使用 Google Chrome 瀏覽器 以利程序進行

請登入系統，並填完基本資料即完成會員註冊

忘記密碼 申請帳號 登入系統

TEMI 會員專區

Welcome 陳建宇

網站首頁 會員專區首頁

注意!!! 第一次登入請完成會員資料登錄以便進行各項線上服務

管理區首頁 會員資料管理 能力認證 培訓報名 文件下載

英文姓名請務必填寫正確，並且仔細閱讀上傳照片的注意事項
上述資料有關證書印製，煩請務必填寫正確

TEMI 會員專區

temi.org.tw/member_area/member/edit_member_self/

台灣嵌入式暨單晶... (一字)TEMI線上教... TEMI 網站管理系統 競賽單位登入 - 管... 外交部領事事務局 - ...

TEMI 會員專區 Welcome 陳建宇

網站首頁 會員專區首頁 > 編輯會員基本資料

管理區首頁 會員資料管理 能力認證 培訓報名 文件下載

編輯會員基本資料

會員基本資料(國籍：台灣)

* 中文姓名

* 英文姓名 PS.

* 性別 男 女

生日

* 身份證號

* 聯絡電話

* 行動電話

* Email

* 縣市

* 學歷

* 學校名稱 PS.

其他學校

服務單位名稱

所屬縣市童軍會

上傳照片注意事項:

1. 照片尺寸：寬3.5cm、高4.5cm、解析度300像素/英寸(DPI)；
像素尺寸：寬413像素、高531像素；
頭部及肩膀頂端逆拍，臉部位照片區佔70~80%。
2. 背景需以白色或任一單色拍攝。
3. 穿著整齊、鮮明、高品質，無圖飾或標識。
4. 此照片將印製於證書上，請勿上傳掃描檔、自拍照片或生活照。

* 通訊地址

* 職稱

* 科系所

其他學校科系所

部門

三、認證梯次報名

The screenshot shows the TEMI member area interface. On the left, a navigation menu is visible with '能力認證' (Ability Certification) selected and '能力認證梯次查詢' (Ability Certification Ladder Query) highlighted with a red box. The main content area is titled '編輯會員基本資料' (Edit Member Basic Information) and shows a form for '會員基本資料(國籍：台灣)' (Member Basic Information (Nationality: Taiwan)). The form includes fields for '中文姓名' (Chinese Name), '英文姓名' (English Name), '性別' (Gender) with radio buttons for '男' (Male) and '女' (Female), and '生日' (Date of Birth). A 'PS.' button is next to the English Name field.

選擇欲報名的梯次

The screenshot shows the '能力認證梯次表' (Ability Certification Ladder Table) page. It features a navigation bar with various menu items and a search bar. Below the search bar, there are filters for '全部職類' (All Categories) and '全部級別' (All Levels). The main content is a table listing certification events. The table has the following columns: '梯次編號' (Ladder Number), '職類' (Category), '級別' (Level), '考試地點' (Exam Location), '考試日期' (Exam Date), '梯次名稱' (Ladder Name), '報名人數/上限' (Number of Applicants/Upper Limit), '報名時間' (Registration Time), and '線上報名' (Online Registration). The table contains four rows of data, with the first row having a '報名' (Register) button and the others having '已結束' (Ended) buttons.

梯次編號	職類	級別	考試地點	考試日期	梯次名稱	報名人數/上限	報名時間	線上報名
UK2505	電子元件拆與鑲能力認證	知識力級	TKB甄戰學習顧問中心	2025-02-23	0223台南甄戰-拆鑲知識力認證	0 / 10	2025-02-18 2025-02-19	報名
UP24555	電子元件拆與鑲能力認證	費用級	龍華科技大學	2025-02-07	0207龍華-拆費培訓認證專班(下午梯)	41 / 42	已結束	已結束
UK2401	電子元件拆與鑲能力認證	知識力級	德明財經科技大學	2025-02-05	0205德明-電子創客知識力培訓暨認證	4 / 30	已結束	已結束
PK2401	電路板設計國際能力認證	知識力級	德明財經科技大學	2025-02-04	0204德明-電路板設計知識力培訓暨認證	7 / 30	已結束	已結束

如有“免試科目”請務必點選正確

能力認證報名入口

能力認證 線上報名



報名基本資訊 認證說明 認證流程 考場一覽 考場 Gmap

梯次編號: UK2505 備註: [Redacted]

職類: 電子元件拆與銲能力認證 級別: 知識力級

考試地點: [Redacted] 考試日期: 2025-02-23

報名時間: 2025-02-18~2025-02-19

免試科目說明:

- 1.實用級免試學科:須為相關科系之碩士以上畢業者,才可點選。(須檢附畢業證明)
- 2.專業/專家級免試學科:須為相關科系之博士畢業者,才可點選。(須檢附畢業證明)
- 3.學、術科成績僅保留3年,線上申請免試科目請填選((免試科目)) 和右邊的((通過年度)),以利審核。

免試科目: [Dropdown] 通過年度: [Dropdown]

報名留言:

[Text input field for registration comments]

培訓活動報名

電路板設計知識力認證講師研習

活動地點: TEMU教育訓練中心
活動日期: 2024-08-31~2024-08-31
報名日期: **報名截止**
» 更多活動查詢

聯絡資訊

台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會

信箱: temi@temi.org.tw
電話: (02)2223-9560#505
(02)8227-5565
傳真: (02)8227-5559

nounal [Input field] 確認報名 **繼續瀏覽梯次**

顯示報名成功即可,也可進入會員專區查詢

能力認證報名入口

能力認證 線上報名



感謝您 報名成功!!!請到會員專區 查詢報名紀錄

報名基本資訊 認證說明 認證流程 考場一覽 考場 Gmap

梯次編號: UK2505 備註: [Redacted]

職類: 電子元件拆與銲能力認證 級別: 知識力級

考試地點: [Redacted] 考試日期: 2025-02-23

報名時間: 2025-02-18~2025-02-19

免試科目說明:

- 1.實用級免試學科:須為相關科系之碩士以上畢業者,才可點選。(須檢附畢業證明)
- 2.專業/專家級免試學科:須為相關科系之博士畢業者,才可點選。(須檢附畢業證明)
- 3.學、術科成績僅保留3年,線上申請免試科目請填選((免試科目)) 和右邊的((通過年度)),以利審核。

免試科目: [Dropdown] 通過年度: [Dropdown]

報名留言:

[Text input field for registration comments]

培訓活動報名

電路板設計知識力認證講師研習

活動地點: TEMU教育訓練中心
活動日期: 2024-08-31~2024-08-31
報名日期: **報名截止**
» 更多活動查詢

聯絡資訊

台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會

信箱: temi@temi.org.tw
電話: (02)2223-9560#505
(02)8227-5565
傳真: (02)8227-5559

地址: 235新北市中和區中興路二段419號6樓之一

st [Input field] 請輸入左圖所顯示英文 確認報名 繼續瀏覽梯次

四、相關資訊查詢-登入會員專區

可查詢 報名紀錄、繳費狀態、免試科目、學術科成績 及 成績狀態

TEMi 會員專區

temi.org.tw/member_area/cert/cert_apply_record/

TEMi 會員專區

會員專區首頁 > 能力認證報名紀錄

繳費狀態	梯次編號	職類	級別	考試時間	考試地點	免試科目/通過年度	准考證號碼	學科成績	術科成績	成績狀態	備註	報名日期
未審核	MP18119	單晶片能力認證	實用級	2018-12-22	明志科技大學	無		60	及格	通過		

5. 繳費資訊

★ 銀行匯款:

銀行名稱	第一銀行 (代號 007)
分行名稱	仁愛分行 (代號 1602)
戶名	台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會
帳號	16010082093

★ ATM 匯款:

銀行名稱	第一銀行 (代號 007)
帳號	16010082093

※注意事項:

匯款完畢煩請回傳下列資訊，以利查核款項，未回傳者，該筆款項將無法查核，謝謝！

1. 回傳匯款收據或照片，亦可提供匯款日期及帳號後 5 碼
2. 參與活動或認證者的姓名
3. 活動或認證之日期、名稱、地點

【回傳方式】

1. E-MAIL: temi@temi.org.tw
2. 傳真: (02) 8227-5559